

EDSFair2013 出展対象製品分類一覧

1 ハードウェア・ソリューション	計測器
システムLSI	その他
ASIC/ASSP	
MPU/MCU/DSP	
FPGA/PLDデバイス	
その他	
2 ハードウェア開発環境EDA	5 IPコア、マクロ、セルライブラリ
①LSI設計関連ツール	6 組み込みプロセッサ開発環境
システムレベル設計(RTLより高位)	リコンフィギャラブルプロセッサ
論理設計(RTL~ネットリスト)	ICE
論理検証	デバッグ
アナログ設計・検証	マイコンCASE
レイアウト	コンパイラ/クロスコンパイラ
レイアウト検証・解析	シミュレータ
LSI信号解析	ハード/ソフト協調設計環境
テスト設計(DFT/BIST/ATPGなど)	その他
DFM関連(OPC/RET/PSM/LRC/TCADなど)	7 設計サービス関連
ASICプロトタイピング	デザインセンタ
その他	設計サービス
②PCB/SIP設計関連ツール	設計コンサルティング
回路図作成	試作・製造
アナログ設計・検証	IP流通サービス
レイアウト	その他
SI/PI/EMC解析	8 設計インフラ(WS/PC、ネットワーク)
電磁界解析	9 設計データ管理ツール
熱解析	設計データ管理
その他	その他
3 ソフトウェア・ソリューション	10 マスクメーカー、ファウンダリメーカー
組み込みOS	11 大学(研究室)、コンソーシアム
デバイスドライバ	12 PR関連
ファームウェア	出版物
モデルウェア	その他
仮想開発環境・技術	
その他	
4 LSIテスト、計測器	
LSIテスト	
PCBテスト	

出展者セミナーカテゴリー一覧

(A) システム設計・検証 (早期SW開発手法/各種プロトタイピング手法を含む)	(J) SIP
(B) Low Power	(K) テスト設計
(C) タイミング	(L) フィジカル検証
(D) DFM	(M) フィジカルインプリメンテーション
(E) 信頼性(パワーインテグリティ)	(N) ロジック設計
(F) AMS設計/検証	(O) 設計・検証サービス
(G) 機能検証(プロトタイピング手法を含む)	(P) 電磁界/熱/流体解析
(H) IP	(Q) FPGA関連
(I) PCB	(R) その他



electronic design and solution fair 2013

出展申込書・契約書

申込方法

別紙「出展規程」をご一読いただき、本申込書に必要事項をご記入・捺印のうえ、下記宛にお申し込みください。

申込先

一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
Tel:(03)6212-5231 Fax:(03)6212-5225
E-mail: info2013@edsfair.com

2013.11.20 WED 水 ~ 22 FRI 金

会場：パシフィコ横浜

主催：JEITA 一般社団法人 電子情報技術産業協会

同時開催：Embedded Technology 2013

www.edsfair.com

申込締切	2013年6月28日(金)	事務局記入欄	確認	受付整理番号	会員	入力	請求	小間番号
受領日								

■ プロフィール:下記のうち、該当するものに☑をつけてください。 ※印は必須項目

<input type="checkbox"/> 過去にEDSFairへの出展経験がある	<input type="checkbox"/> 出展経験なし	※初出展の場合は、本申込書に会社案内と製品パンフレットを添付してください。
<input type="checkbox"/> 日本エレクトロニクスショー協会会員である	<input type="checkbox"/> 会員ではない	

■ 申込小間数および出展小間料
希望する小間形態にひとつ☑を付け、出展小間数・出展小間料をご記入ください。

小間形態	出展申込小間数	出展小間料金(消費税込)	
スタンダードブース <input type="checkbox"/> 一列小間(1,2,3,4,5,6) <input type="checkbox"/> 二列小間(4,6,8,10,12) <input type="checkbox"/> 三列小間(9,12,15,18) <input type="checkbox"/> 四列小間(16) <input type="checkbox"/> ブロック小間(20,25,30,35,40,45,50)	小間	1~3小間 @451,500円(一般法人) @399,000円(会員企業)	円
<input type="checkbox"/> スモールパッケージブース(1,2)	小間	@367,500円	円
<input type="checkbox"/> 新興ベンダエリア(1,2,3)	小間	@252,000円	円
<input type="checkbox"/> ユニバーシティプラザ(1,2,3)	小間	@105,000円	円

■ 出展予定製品分類
裏面の「出展対象製品分類一覧」を参照し、出展を予定している全ての分類番号に☑を付けてください

<input type="checkbox"/> 1.ハードウェアソリューション	<input type="checkbox"/> 5.IPコア、マクロ、セルライブラリ	<input type="checkbox"/> 9.設計データ管理ツール
<input type="checkbox"/> 2.ハードウェア開発環境(EDA)	<input type="checkbox"/> 6.組込みプロセス開発環境	<input type="checkbox"/> 10.マスクメーカー、ファウンドリメーカー
<input type="checkbox"/> 3.ソフトウェアソリューション	<input type="checkbox"/> 7.設計サービス関連	<input type="checkbox"/> 11.大学(研究室)、コンソーシアム
<input type="checkbox"/> 4.LSIテスト、計測器	<input type="checkbox"/> 8.設計インフラ(WS/PC、ネットワーク)	<input type="checkbox"/> 12.PR関連(出版物、他)

■ 出展者セミナー
裏面の「出展者セミナーカテゴリー一覧」を参照し、講演予定内容に基づき希望するセッションカテゴリーに☑を付け、申込セッション数をご記入し、合計セッション数と料金をご記入ください。

カテゴリ	セッション数	カテゴリ	セッション数
<input type="checkbox"/> A: システム設計・検証	セッション	<input type="checkbox"/> K: テスト設計	セッション
<input type="checkbox"/> B: Low Power	セッション	<input type="checkbox"/> L: フィジカル検証	セッション
<input type="checkbox"/> C: タイミング	セッション	<input type="checkbox"/> M: フィジカルインプリメンテーション	セッション
<input type="checkbox"/> D: DFM	セッション	<input type="checkbox"/> N: ロジック設計	セッション
<input type="checkbox"/> E: 信頼性	セッション	<input type="checkbox"/> O: 設計・検証サービス	セッション
<input type="checkbox"/> F: AMS設計/検証	セッション	<input type="checkbox"/> P: 電磁界/熱/流体解析	セッション
<input type="checkbox"/> G: 機能検証	セッション	<input type="checkbox"/> Q: FPGA関連	セッション
<input type="checkbox"/> H: IP	セッション	<input type="checkbox"/> R: その他	セッション
<input type="checkbox"/> I: PCB	セッション	具体的なカテゴリ名をご記入ください	
<input type="checkbox"/> J: SIP	セッション		
合計	セッション	@ 63,000円	円(消費税込)

■ スイートルーム
希望するお部屋タイプの部屋数と使用料をご記入ください。

タイプ	部屋数	使用料(消費税込)	
S (3.96 m × 3.96 m)	部屋	@ 367,500円	円
M (5.94 m × 3.96 m)	部屋	@ 441,000円	円
L (5.94 m × 4.95 m)	部屋	@ 504,000円	円

■ 出展申込者
ご記入いただいた情報は印刷物や公式Websiteへ反映されますので、正確にご記入ください。特に英文は、大文字・小文字の表記などに十分ご注意ください。

会社名	フリガナ										
	和文										
会社代表者	フリガナ										
	和文	(〒)									
本社所在地	英文										
	役職	ご氏名									
出展担当者	フリガナ										
	所在地	(〒)									
	フリガナ	フリガナ									
	所属・役職	ご氏名									
	電話番号	F A X									
請求担当者	E-mail										
	フリガナ										
	所在地	(〒)									
	フリガナ	フリガナ									
	所属・役職	ご氏名									
ホームページURL	電話番号	F A X									
	E-mail										
	国内向け	海外向け									

■ EDSFair2013「出展規程」に定める事項を遵守し、上記のとおり申し込みます。

出展責任者: 会社名	_____
役職	_____
氏名	_____ (印)

※貴社(団体)の本展示会の出展に係る責任者の記名、押印をお願いいたします。